



シリコンウェーハはテクノロジーの根源

SUMCO 株主通信

第23期 中間期 2021年1月1日 > 2021年6月30日

INDEX

- 01 ごあいさつ
連結業績 ハイライト
- 03 特集：300mmシリコンウェーハ市場
- 05 市場環境と業績見通し
- 06 会社情報・株式情報・株主メモ



- 1 技術で世界一の会社
- 2 景気下降局面でも赤字にならない会社
- 3 従業員が生き活きとした利益マインドの高い会社
- 4 海外市場に強い会社


代表取締役 会長兼CEO
橋本 眞幸

代表取締役 副会長 CFO
瀧井 道治

株主の皆様には日頃から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2年目を迎えた新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の中で、当社はお客様、サプライヤー、地域社会、全世界の従業員およびその家族の安全を第一に考え、さまざまな思索と実践を日々重ねてまいりました。また、拡大阻止のため、医療従事者や生活必需品の提供や物流に携わる方々をはじめ、世界中で昼夜を問わず多くの方々が懸命の取り組みを続けておられます。これらの皆様のご尽力に敬意を表しますとともに、罹患された方々の早期回復と一日も早い感染の終息を心よりお祈り申し上げます。

当第2四半期累計連結会計期間における半導体用シリコンウェーハ市場は、米中貿易摩擦やコロナ禍による世界経済の減速にも拘わらず成長しました。300mmシリコンウェーハはテレワーク・5Gの浸透による通信容量の増大による旺盛な需要のもとで、ロジック向けウェーハはPC・スマートフォン・データセンター向け需要に牽引され、更にタイト感が増幅しました。また、メモリー向け300mmウェーハもDRAMに続きNANDも回復に転じたことから需給は逼迫し始めました。200mm以下の小口径ウェーハも、車載・民生・産業向け需要の拡大により、供給が需要に追いつかない状況が続きました。

第3四半期の300mmシリコンウェーハ市場も、ロジック向けに加えメモリー向けの需要増加により更なる需給逼迫を見込んで

おります。また、200mm以下ウェーハについても強い需要に支えられ、需給タイトな状況が続くと予想しております。

このような市場環境のもと、当社グループでは、引き続き需要増が見込まれる最先端品の技術開発の推進による製品の差別化を図るとともに、AIの深耕による生産性改善や需要に合わせた継続的な設備増強を進めることにより、顧客要求に応えていく所存です。また、コロナ禍や米中貿易摩擦等の影響を含め、市場環境の動きを注視してまいります。

以上に基づき、2021年12月期の中間配当につきましては、当期における利益水準、将来の見通し、設備投資に係る資金需要および内部留保の状況等を総合的に勘案し、1株当たり17円、連結配当性向は30.2%といたします。

今後とも倍旧のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸

株主の皆様には平素より当社へのご理解とご支援をいただき厚く御礼申し上げます。

当上期の半導体シリコンウェーハは、コロナ禍の世界経済への影響が懸念されたにも拘わらず半導体業界は好況となったことから、300mmロジック向けウェーハを中心に好調な需要に支えられ、前年同期と比べて売上高が約7%、106億円増加しました。一方コスト面では、300mm最先端高精度シリコンウェーハの増強投資による減価償却費や生産拡大による修繕費等の増加もあり、利益は若干の減益となり、営業利益は217億円、親会社株主に帰属する純利益は163億円となりました。

財務体質は継続して改善しており、自己資本比率は対前年同期末対比1.2%改善した54.3%、D/Eレシオは0.04改善した0.44となり、中期的な目標としていた自己資本比率50%以上、グロスD/Eレシオ0.5倍以下という数値を達成しております。

今後とも最先端半導体デバイスの需要に対して顧客の要求に応えるべく最先端高精度シリコンウェーハの技術開発と逐次増強を進めながら、歩留改善、原単位低減、生産性向上等のコストダウンを推進し、財務体質強化とともに収益の改善に努めてまいります。

また、ESGやSDGsに示されている種々の項目についても目標を定めて取り組んでまいります。

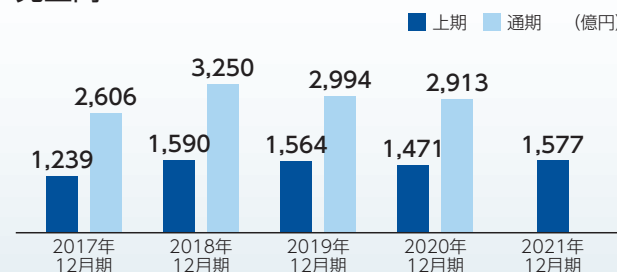
株主の皆様には、今後も引き続きご支援を賜りたくお願い申し上げます。

代表取締役 副会長 CFO 瀧井 道治

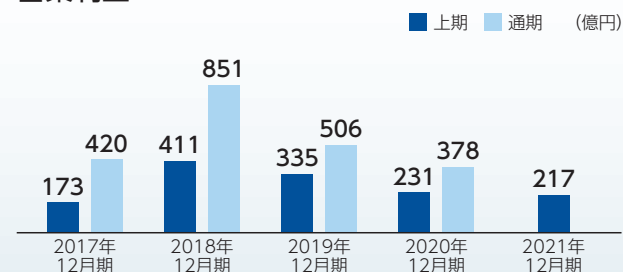
▶ 連結業績 ハイライト

(注) 日本会計基準。グラフ中の数字は億円未満切り捨て。

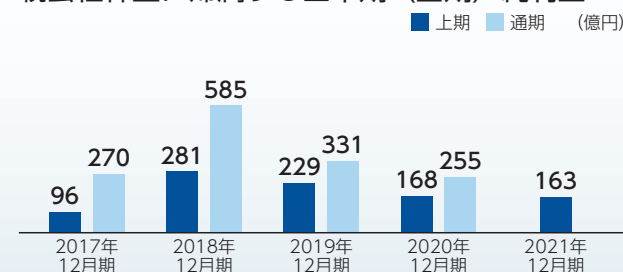
売上高



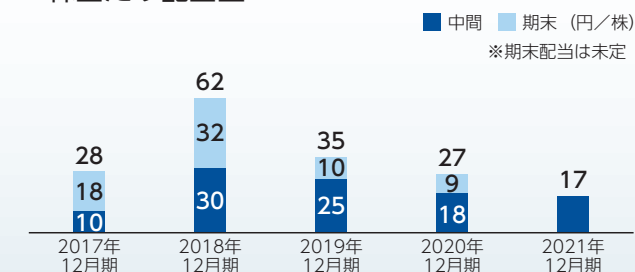
営業利益



親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益



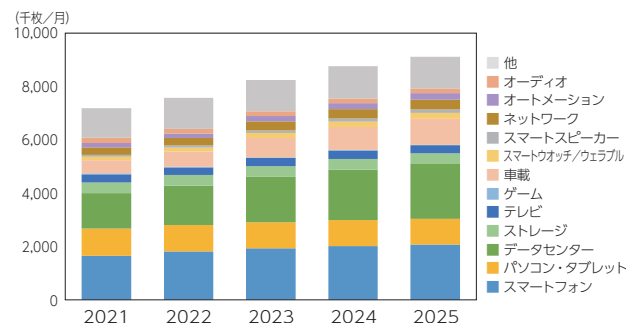
1株当たり配当金



シリコンウェーハは成長産業

- IoT、5Gの普及により、スマートフォン・データセンター向けの市場拡大に牽引されて、300mmシリコンウェーハ市場は、成長が期待されております。(図1)
- 電気自動車、自動運転の普及により、車載向けデバイスの伸長が予想されます。

図1. 300mmシリコンウェーハの用途別需要予想

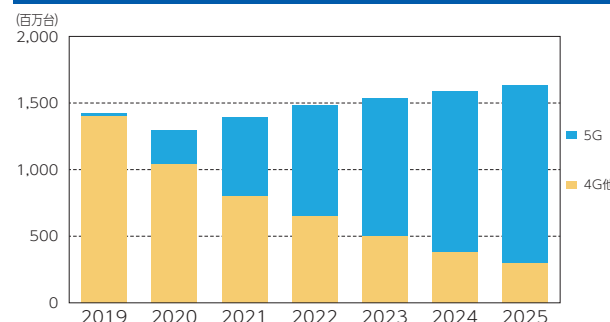


【出典:調査会社予想データを基に、SUMCO推定】

スマートフォン向け需要

- 5Gスマートフォンの普及は急速に進んでおり、2022年には台数需要の過半数が置き換わると予想されています。(図2)
- 5Gスマートフォンは高性能・高機能で、1台当たりに使用されるシリコンウェーハ面積は4Gより増加するので、シリコンウェーハ需要の伸びが予想されます。

図2. 5Gスマートフォンの台数需要予想

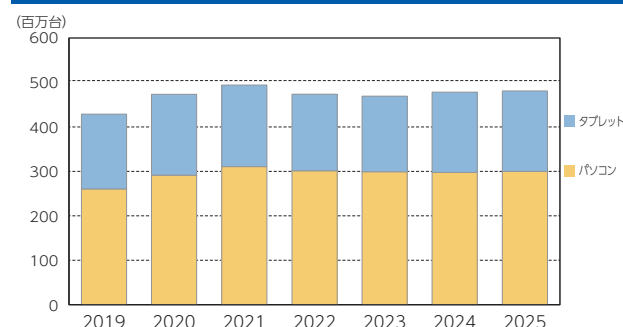


【出典:調査会社データよりSUMCO作成】

パソコン・タブレット向け需要

- パソコン・タブレットの台数は、過去には減少も予想されましたが、Web会議、オンライン授業の定着により、2020年並みの需要が続くと想定されます。(図3) シリコンウェーハも安定した需要が継続する見通しです。

図3. パソコン・タブレットの台数需要予想

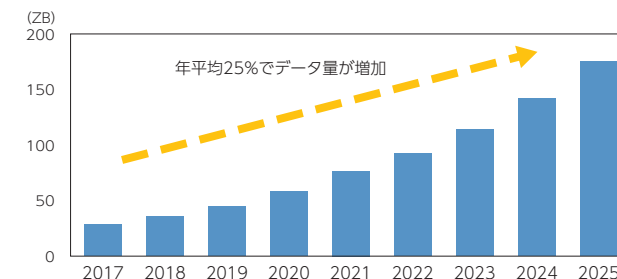


【出典:調査会社データよりSUMCO作成】

データセンター向け需要

- 世界のデータ量は、映画・動画・音楽の配信サービスとクラウドゲームの市場拡大に伴い、年平均25%の増加が予想されます。(図4)
- ビッグデータの時代に向かって、データセンターへの投資を増加し、シリコンウェーハ市場を牽引します。

図4. 世界のデータ量予想

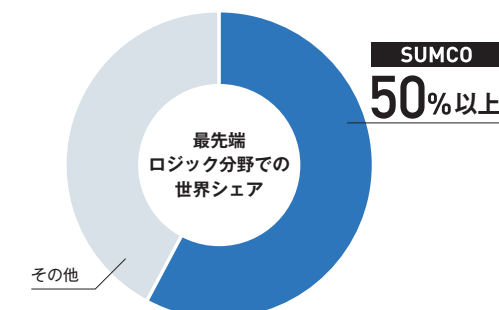


【出典:調査会社データよりSUMCO作成】

SUMCOは最先端ロジック用ウェーハで世界シェアNO.1

- スマートフォンのプロセッサやパソコン・データセンターのCPUといった頭脳部分には、最先端ロジック用の高精度シリコンウェーハが使われています。
- SUMCOはお客様から高い技術開発力、安定した品質、製品の安定供給力が評価され、最先端ロジック分野で高いシェアをいただいております。(図5)
- これからもお客様の開発パートナーとして、高度化する品質要求に応えてまいります。

図5. 最先端ロジック用分野での世界シェア



【出典:各種資料よりSUMCO推定】



設備投資が続くデータセンター

市場環境と業績見通し

2021年度上期
(1-6月)
市場環境

2021年度上期における半導体用300mmロジック向けウェーハは、PC・スマートフォン・データセンター向け需要に牽引され、更にタイト感が増幅しました。また、メモリー向けもDRAMに続きNANDも回復に転じたことから需給は逼迫し始めました。200mm以下の小口径ウェーハも、車載・民生・産業向け需要の拡大により、供給が需要に追い付かない状況が続きました。

2021年度上期
(1-6月)
事業成績

このような環境のもと、当社グループでは、「SUMCOビジョン」に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により、顧客での高いプレゼンスを維持するとともに、コスト改善により損益の改善にも努めてまいりました。
この結果、2021年度上期における当社グループの業績は、売上高1,577億円、営業利益217億円、経常利益209億円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は163億円となりました。

今後の見通し
2021年度3Q
累計(1-9月)

2021年度3Q(7-9月)における半導体用300mmシリコンウェーハ市場は、ロジック向けに加えメモリー向けの需要増加により更なる需給逼迫を見込んでおります。また、200mm以下ウェーハについても強い需要に支えられ、需給タイトな状況が続くと予想しております。
このような市場環境のもと、2021年度3Q累計の業績見通しについては、下表1.の通り予想しています。なお、2021年度3Q(7-9月)の為替前提は110円/USドルとしています。

図表1.営業利益増減分析(2020年度上期→2021年度上期)

(単位: 億円)			
	2020年度上期	2021年度上期	増減
売上高	1,471	1,577	+ 106
営業利益	231	217	▲14
為替 (円/US\$)	108.5	107.4	▲1.1

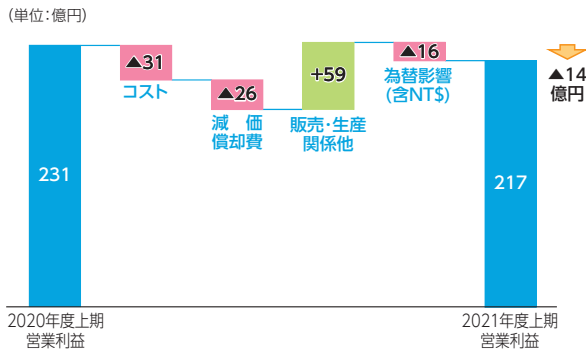


表1.2021年度3Q(1-9月)累計連結業績予想

項 目	2020年度3Q累計 実績(1-9月)	2021年度3Q累計 予想(1-9月)	増減
売上高	(億円) 2,187	2,437	+250
営業利益	(億円) 297	342	+45
経常利益	(億円) 285	329	+44
親会社株主に帰属する 四半期純利益	(億円) 202	253	+51
1株当たり四半期純利益 (円)	69.3	87.1	+17.8
為替 (円/US\$)	107.7	108.3	+0.6

注) 業績予想等の将来に対する記述は、当社が現在入手している情報、および合理的と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

会社情報

会社概要(2021年6月末現在)

商号	株式会社SUMCO
本社	〒105-8634 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 Tel : 03-5444-0808 https://www.sumcosi.com/
設立年月日	1999年7月30日
資本金	138,718百万円
従業員数	連結8,280名 単体4,093名
IRお問い合わせ先	広報・IR室 : 03-5444-3915

取締役(2021年6月末現在)

代表取締役 会長兼CEO	橋 本 眞 幸
代表取締役 副会長	瀧 井 道 治
代表取締役 社長兼COO	降 屋 久
代表取締役 副社長	平 本 一 男
取締役	加 藤 茜 愛 *
取締役(常勤監査等委員)	井 上 文 夫
取締役(監査等委員)	田 中 等 *
取締役(監査等委員)	三 富 正 博 *
取締役(監査等委員)	太 田 信一郎 *
取締役(監査等委員)	不 破 章 雄 *

* 社外取締役(独立役員)

株式情報

株式情報(2021年6月末現在)

発行可能株式総数	804,000,000株
発行済株式総数	290,175,139株
総株主数	76,783名

株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	Tel : 0120-782-031 (フリーダイヤル)
インターネットホームページURL	https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株主メモ



第23期 中間期 株主通信

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会	毎年3月開催
基準日	定時株主総会議決権行使株主確定日 毎年12月31日 配当金支払株主確定日 期末配当金 毎年12月31日 中間配当金 毎年 6月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
公告の方法	電子公告とし、当社のホームページ (https://www.sumcosi.com/)に掲載いたします。 ただし、事故その他のやむを得ない事由によって 電子公告による公告ができない場合は、日本経済 新聞に掲載して公告いたします。
上場取引所	東京証券取引所 市場第一部(証券コード:3436)

ホームページのご案内

当社は多くの株主・投資家の皆様にご利用いただけるよう、ホームページの充実を図っております。決算関係資料やニュースリリースなどのほか、当社が製造するシリコンウェーハについての情報なども掲載しております。ぜひご利用ください。

SUMCOホームページ <https://www.sumcosi.com/>

■ 株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

- 証券会社に口座を開設されている株主さまは、住所変更等のお手続きおよびご照会は、口座のある証券会社にてお願いいたします。
- 証券会社に口座を開設されていない株主さまは、下記電話照会先までご連絡ください。

■ 単元未満株式の買取請求について

単元(100株)未満株式の買取請求につきましては、株主さま口座のある証券会社にお申し出ください。
(証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主さまは、特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。)

For All Innovation

半導体の進化が世の中を変える

時代を変え、風景を変え、あなたと私のこれからを変える

次の100年、半導体でどう変わるだろうか

シリコンウェーハは半導体テクノロジーの根源

半導体の進化が未来を創る

SUMCO

株式会社SUMCO

〒105-8634 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館

Tel:03-5444-0808

<https://www.sumcosi.com/>

見通しに関する注意事項

本資料に記載された予測・予想・見込み・その他の将来情報および将来推定は、現時点で当社が利用可能な情報および一定の前提または仮定(当社の主観的判断に基づくものを含みます。)に基づくものです。

実際の業績などは、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向、その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報および将来推定と大きく異なる可能性があります。



環境保護のために、
大豆インクを
使用しております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。